



Max-Planck-Innovation

Technologieangebot

Max-Planck-Innovation GmbH
Amalienstr. 33
80799 Munich
Germany

Phone: +49 (89) 29 09 19 - 0
Fax: +49 (89) 29 09 19 - 99
info@max-planck-innovation.de
www.max-planck-innovation.de

DECONV-Software

AZ.: 1401-4358-WT-WA

Kontakt:
Wolfgang Tröger
Tel.: 089 / 290919-27
troeger@max-planck-innovation.de

Technologie

Das Verfahren der Lock-in-Thermographie (LIT) gestattet es, 2-dimensionale Bilder der Verteilung der in einer Probe dissipierten Leistung zu erzeugen. Allerdings sind diese Lock-in-Thermogramme noch durch die unvermeidliche laterale Wärmediffusion in der Probe "verbreitert" (blurred). Das "DECONV"-Programm gestattet es, diese thermische Verbreiterung durch die Anwendung eines örtlichen Entfaltungs-Verfahrens wieder rückgängig zu machen und dadurch die effektive Ortsauflösung der Lock-in-Thermographie zu verbessern. Die CD enthält neben der eigentlichen Software eine ausführliche Programmbeschreibung in Englisch und Beispiel-Files, auf die das Programm angewendet werden kann. Dieses Programm ist die Weiterentwicklung einer früheren Software ("Vektorielles Entfaltungsprogramm" vom 18.08.1998).

Eine Single-User-Lizenz der Software DECONV (Version 8.0) ohne Quellcode kostet

EUR 750,--

Dieser Preis beinhaltet:

1. Die Lizenzgebühr zur nicht-exklusiven Nutzung dieser Software.
2. Die Software und das Manual werden im PDF- und PostScript-Format zur Verfügung gestellt (entweder per E-Mail oder CD-ROM).

Literatur

- Highly Sensitive Lock-in Thermography Investigation of Local Heat Sources Implying 2-Dimensional Spatial Deconvolution
O. Breitenstein, I. Konovalov, and M. Langenkamp
http://www.mpi-halle.mpg.de/mpi/publi/pdf/1542_01.pdf
- Lock-in IR-Thermography - a novel tool for material and device characterization
S. Huth, O. Breitenstein, A. Huber, D. Dantz, U. Lambert, F. Altmann
http://www.mpi-halle.mpg.de/mpi/publi/pdf/540_02.pdf
- Quantitative Evaluation of Shunts in Solar Cells by Lock-In Thermography
O. Breitenstein, J. P. Rakotoniaina, M. H. Al Rifai
Prog. Photovolt: Res. Appl. 2003; 11:515-526